

常州中英科技股份有限公司

海通证券股份有限公司

关于申请首次公开发行股票并在创业板上市

上市委审议意见的落实函

回复报告

保荐机构（主承销商）



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

深圳证券交易所：

贵所于 2020 年 8 月 13 日出具的《关于创业板上市委审议意见的落实函》（审核函〔2020〕010322 号，以下简称“落实函”）已收悉。

根据贵交易所的要求，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“中英科技”或“发行人”）会同海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）对上市委意见落实函中所提问题逐项核查，具体回复如下，请予审核。

除非本回复中另有说明，招股说明书中使用的释义和简称适用于本回复。

本回复报告的字体：

黑体加粗：	落实函所列问题
宋体及宋体加粗：	对落实函所列问题的回复
楷体加粗：	对招股说明书的修改
楷体不加粗	对招股说明书内容的引用

在本落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

1. 请发行人在招股说明书中补充披露高新技术企业资质续期的最新进展。

回复：

发行人已在招股说明书“重大事项提示”中补充披露“六、公司申请高新技术企业认证的进展情况”，具体补充披露如下：

公司于2016年11月30日取得高新技术企业证书，证书有效期三年，于2019年11月30日到期，公司2019年进行了高新技术企业申报，但由于申报材料的技术领域划分与公司主营业务情况存在偏差，公司未通过高新技术企业的认证。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组2020年3月27日发布的《关于组织申报2020年度高新技术企业的通知》，江苏省2020年度的高新技术企业申报工作已经开始。公司对申报材料进行了认真准备，并请常州市科技局的相关专家予以指导和协助，经专业分析和论证后，公司选择了适当的技术领域，再次进行了高新技术企业申报。

经查询江苏省高新技术企业辅助材料提交系统，公司已提交2020年度高新技术企业申报申请及相关申请文件，尚处于等待评审状态。

公司本次发行上市后，将及时公开披露公司高新技术企业申报的最新进展。

2. 请发行人在招股说明书“风险因素”章节补充披露 2019 年以来收入下降对发行人持续经营能力的影响。

回复：

发行人已在招股说明书“风险因素”之“五、财务风险”中补充披露“(一)营业收入下降的风险”，并在招股说明书重大事项提示中作了重大风险提示，具体披露内容如下：

公司产品主要为高频覆铜板和高频聚合物基复合材料，报告期内，公司上述产品主要应用与 4G、5G 基站中，移动通信领域，特别是下游通信基站的建设需求对公司营业收入的变动影响较显著。

2019 年，公司营业收入虽同比 2018 年保持稳定，但由于国内 4G 建设进入尾声，5G 建设尚未大规模开启，国内市场需求下降，当期境内收入同比下降 23.84%。其中，2019 年第四季度，由于来自移动通信领域的需求下降，公司销售收入同比下降 54.68%。

2020 年上半年，新冠疫情影响了国内一季度基站建设进度和下游行业的生产复工，导致公司一季度收入同比下降 41.93%，虽然二季度以来国内 5G 建设开启使得公司销售订单快速增加，但 2020 年上半年收入依然同比下降 16.57%。

由于下游通信基站的建设需求对公司销售收入的影响较大，如果未来受疫情、国际贸易摩擦等事件影响，国内外 5G 基站建设进度放缓，可能会导致公司营业收入下降，影响公司的整体业绩。

3. 请发行人全面核查招股说明书中有关产品市场占有率、产品认证信息披露的数据来源及准确性。请保荐人发表明确意见。

一、关于公司产品市场占有率的披露

1、公司在高频覆铜板市场的占有率

公司在招股说明书第二节“概览”之“四、发行人主营业务描述”、“五、发行人符合创业板定位的相关说明”以及第六节“业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品的基本情况”、“三、发行人的竞争地位”中对公司市场占有率情况进行了如下披露：

“2018 年，全球高频覆铜板 80%以上的市场份额被罗杰斯、泰康利等美日企业主导，国内从事高频覆铜板生产的企业主要为中英科技和生益科技。公司在高频覆铜板领域的市场占有率为 6.4%，仅次于罗杰斯、泰康利。”

“公司是国内较早开始研发、生产高频覆铜板的企业。2013 年，公司高频覆铜板开始实现大批量销售，目前已得到京信通信、通宇通讯、ACE、华为、康普、罗森伯格等多家天线厂商的产品认证。近 6 年来，高频覆铜板销售量持续增长，是国内领先的高频覆铜板生产商。2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年，公司高频覆铜板销售收入分别为 10,904.58 万元、13,829.87 万元、16,316.85 万元和 16,836.10 万元，2016 年-2018 年的高频覆铜板市场占有率如下：

单位：亿元

类别	2016 年	2017 年	2018 年
中英科技高频覆铜板销售收入（含税）	1.28	1.60	1.88
高频覆铜板市场需求 ¹	25.46	28.04	30.63
市场占有率	5.01%	5.71%	6.14%

注 1：2019 年尚无公开可取得的市场需求统计数据；

注 2：公司按照经审计后收入为基础计算的市场占有率 6.14%与 Prismark 的研究报告中统计的公司 2018 年在高频覆铜板领域的市场占有率为 6.4%略有差异，主要系：Prismark 的市场占有率系按照其统计的公司 2018 年高频覆铜板收入 2800 万美元除以 4.39 亿美元的市场份额计算。由于汇率折算、含税收入换算等差异导致与公司计算的数据存在小幅差异。为统一数据来源口径，本招股说明书其他部分引用的公司和同行业公司市场占有率数据均为 Prismark 的统计数据。

”

¹ 需求数据根据 prismark 对应年份的研究报告数据；汇率按照 2019 年 12 月 31 日汇率统一折算。

公司上述关于产品市场占有率的描述，均是基于美国 PrismaMark 的研究报告中对高频覆铜板市场需求的统计数据，上述数据系公开取得。

PrismaMark 是国际知名的电子行业咨询机构，成立于 1994 年，主要提供行业研究、客户咨询、出版报告等服务，其每季度发布的电子材料报告、印制电路板报告、半导体封装报告、电子供应链报告等，具有较高的权威性和独立性。PrismaMark 报告中关于 PCB、覆铜板市场需求的数据及观点被广泛引用，2000 年后 A 股上市的以 PCB、覆铜板为主业的公司招股说明书中对市场需求的描述主要基于 PrismaMark 的研究报告，包括沪电股份(002463.SZ)、深南电路(002916.SZ)、兴森科技(002436.SZ)、景旺电子(603228.SH)、依顿电子(603328.SH)、南亚新材(688519.SH)、超华科技(002288.SZ)等 21 家上市公司。2000 年以前上市的公司生益科技(600183.SH)、超声电子(000823.SZ)、方正科技(601901.SH)等公司在其年度报告中也以 PrismaMark 的统计数据计算行业需求或市场份额。此外，英特尔、超微、英伟达、台积电等半导体供应商，华为、思科、IBM、三星等系统供应商均是 PrismaMark 的客户。

2020 年 5 月，科创板上市的南亚新材(688519.SH)在其披露的招股说明书中同样引用了 PrismaMark 研究报告中高频覆铜板的市场份额数据，其中提到中英科技在 2018 年高频覆铜板市场的占有率位居全球第三，仅次于罗杰斯和泰康利，市场占有率约 5%-10%。

2020 年 8 月，保荐机构访谈了通宇通讯、摩比发展、恩电开、亨鑫科技四家天线生产企业的相关专家，经访谈确认，高频覆铜板每年的市场需求空间保守估计约 30-40 亿元，国外的供应商主要是罗杰斯、泰康利，国内供应商有中英科技、生益科技、华正新材等少数企业，中英科技销售量相对领先，产品质量具备国际竞争力。

2020 年 8 月，保荐机构访谈了中国电子材料行业协会覆铜板材料分会的专家，经访谈，高频覆铜板主要用于通信、汽车、军工等领域，市场需求约 30-40 亿元，5G 相比 4G 需求会有 2-3 倍提升，中英科技是国内较早从事该领域的企业，出货量在国内领先。

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会于 2020 年 8 月出具《情况说明》，根

据协会历年的行业调查统计，自 2013 年以来，中英科技的高频覆铜板产品累计出货量、市场占有率在国内企业中均处于领先地位，在国际市场上逐渐形成强有力的竞争力和较高的知名度。

2、公司在基站天线细分市场的占有率情况

公司在招股说明书第八节“财务会计信息与管理层分析”之“九/（一）/3、主要产品销售数量、价格及变化情况”中披露如下：

“报告期内，发行人一方面积极调动研发力量，不断提升产品技术水准，扩大终端客户群体，另一方面，中国作为全球的 PCB 制造中心，有利于发行人发挥本土优势和服务优势，加强与 PCB 客户、天线厂商的业务关系。上述原因导致公司市场占有率不断提升，发行人在基站天线领域的市场占有率从 2016 年的 7.7% 上升到 2018 年的 14.0%。”

公司在基站天线所需高频覆铜板细分领域的的数据系根据基站天线的需求数量估算，具体测算过程如下：

项目	序号	2016 年度	2017 年度	2018 年度
全球基站天线需求数（万个）	A	644.49	508.42	517.72
每面天线平均高频覆铜板需求量（m ² ）	B	0.34	0.37	0.41
材料利用率	C	80%	80%	80%
全球高频覆铜板需求总量（万 m ² ）	D=B×A÷C	268.52	233.23	262.35
中英科高频覆铜板销售面积（万 m ² ）	E	20.79	28.54	36.73
中英科技高频覆铜板市场占有率	F=E/D	7.74%	12.24%	14.00%

注 1：每年基站天线需求数系根据中国移动各期定期报告、工信部统计数据及中国移动的招标公告以及 EJI Wireless Research 的研究报告等公开数据测算。

注 2：单个基站天线使用发行人产品高频覆铜板的面积通过对不同制式的基站天线需求量加权平均计算。

基站天线领域是高频覆铜板的主要需求市场，约占整个市场的 50% 左右，根据 Prismark 公布的公司在高频覆铜板领域的市场占有率数据推算公司 2018 年在基站天线细分市场占有率约 12%，与公司根据天线市场需求计算的市场占有率数据基本一致。

3、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了 Prismark 于 2019 年出具的覆铜板行业研究报告，查阅了南

亚新材(688519)的招股说明书，并对中国电子材料行业协会覆铜板材料分会以及通宇通讯、摩比发展、恩电开、亨鑫科技四家天线生产企业的相关行业专家进行了访谈，了解高频覆铜板的市场需求和竞争情况。取得了中国电子材料行业协会覆铜板材料分会出具的《情况说明》。同时，保荐机构根据国内三大运营商披露的 2016 年-2018 年基站建设数据、EJL Wireless Research 公布的基站天线需求数据等测算了基站天线领域对高频覆铜板的需求量以及公司对应的市场份额。

经核查，保荐机构认为：公司披露的高频覆铜板市场需求及竞争格局数据与 **Prismark** 研究报告中的数据一致，数据来源客观、权威。中国电子材料行业协会覆铜板材料分会出具的情况说明及通宇通讯、摩比发展、恩电开、亨鑫科技四家天线厂商的相关专家访谈情况进一步印证了相关数据的准确性。公司根据基站天线需求数测算的公司在基站天线领域的市场占有率数据具有合理性。因此，公司关于市场需求及市场占有率的披露准确。

二、关于公司产品认证信息的披露

结合公司在招股说明书第二节“概览”之“四、发行人主营业描述”及第六节“业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品的基本情况”、“三、发行人的竞争地位”等部分的信息披露，公司在招股说明书中披露公司产品通过了以下天线厂商的认证：

华为、康普、京信通信、通宇通讯、ACE、罗森伯格、虹信通信、恩电开、摩比发展。

公司在招股说明书第六节“业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品的基本情况”中补充披露如下产品认证信息：

“公司产品认证是指公司产品通过终端天线厂商的测试后，天线厂商在其 PCB 设计图纸中标识公司产品型号并下达给其 PCB 供应商，PCB 生产企业按照天线厂商的设计图纸要求向公司采购。天线厂商通过公司产品认证后，会邮件或电话通知公司向哪些 PCB 厂商供应产品。

公司产品自 2011 年开始向终端天线厂商申请认证，在国内 4G 建设开启前，通过公司 4G 产品认证的天线厂商为京信通信、华为、通宇通讯。2014 年至 2018

年，公司 4G 产品又通过了康普、罗森伯格、虹信通信、ACE、摩比发展的产品认证。2018 年开始，公司开始申请 5G 产品认证。公司 5G 产品目前分为三个系列，包括 CA 型、D 型、8000 型，其中 CA 型最早于 2018 年通过认证且实现销售；D 型和 8000 型均于 2020 年上半年实现大批量销售。截至本回复出具日，通过公司产品认证的天线厂商的具体认证时间及认证产品类型汇总如下：

终端天线 厂商名称	4G 产品		5G 产品		
	D 型认证时间	CA 型认证时间	D 型认证时间	CA 型认证时间	8000 型认证时间
京信通信	2011 年	2015 年	-	2018 年	2019 年
华为	2013 年	2016 年	2020 年	-	-
康普	-	2015 年	-	2019 年	2020 年
罗森伯格	-	2016 年	-	2020 年	2020 年
ACE	-	2018 年	-	2018 年	2020 年
通宇通讯	2013 年	2017 年	2019 年	2018 年	2019 年
摩比发展	2018 年	2018 年	-	2020 年	-
虹信通信	2014 年	2017 年	-	-	-
恩电开	-	-	2019 年	2019 年	2020 年

2018 年，公司 5G 产品自实现销售以来，随着 5G 建设的兴起，销售规模持续增长。报告期内，公司 4G、5G 产品的具体销售金额及主要客户、主要终端天线厂商情况如下：

单位：万元

系列	项目	2019 年	2018 年	2017 年
4G 产品	销售收入	11,521.85	16,507.24	13,986.13
	占当期营业收入比例	65.28%	94.41%	96.05%
	主要 PCB 客户	艾威尔、安泰诺、协和电子、沪电股份、兴达鸿业等	艾威尔、安泰诺、协和电子、沪电股份、五株科技等	安泰诺、协和电子、沪电股份、五株科技、杰赛科技等
	主要天线厂商	京信通信、华为、通宇通讯、康普、罗森伯格、虹信通信等	京信通信、华为、通宇通讯、康普、罗森伯格、虹信通信等	京信通信、华为、通宇通讯、康普、罗森伯格、虹信通信等
5G 产品	销售收入	5,560.53	320.00	-
	占当期营业收入比例	31.51%	1.83%	-
	主要客户	DURI、艾威尔、安泰诺、沪电股份、	艾威尔、RF Board、沪电股份等	-

		深圳博敏等		
	主要天线厂商	ACE、京信通信、通宇通信	京信通信、通宇通信、ACE	-

”

公司招股说明书中所披露的华为、康普、京信通信、通宇通讯、ACE、罗森伯格、虹信通信、恩电开、摩比发展均通过了公司产品认证，上述企业在向其PCB 客户下达的天线设计图纸中明确标明了公司高频覆铜板产品型号。

保荐机构对公司主要客户沪电股份、DURI、安泰诺、协和电子、艾威尔、五株科技、深南电路、博敏电子等进行了现场走访，根据访谈结果，PCB 客户均系按照天线厂商图纸要求向公司采购，结合访谈确认的 PCB 客户对应的终端天线厂商情况，能够确认公司产品已通过华为、康普、京信通信、通宇通讯、ACE、罗森伯格、虹信通信、恩电开、摩比发展的认证。

保荐机构通过多种方式对基站天线厂商对公司产品的认证情况进行了核查。对华为、康普、京信通信、通宇通讯、ACE 五家天线厂商进行了访谈，访谈确认公司产品通过其认证情况，获取了 ACE、通宇通讯、京信通信、摩比发展、恩电开、罗森伯格六家天线厂商出具的公司产品已用于其基站天线生产的声明。

保荐机构获取并核查了中英科技与华为、康普、京信通信、通宇通讯、ACE、罗森伯格、虹信通信、摩比发展等天线厂商以及 PCB 客户在产品认证、技术交流等方面的沟通资料，确认公司已通过上述天线厂商的产品认证。

通过上述核查，保荐机构认为：公司产品已通过天线厂商华为、康普、京信通信、通宇通讯、ACE、罗森伯格、虹信通信、恩电开、摩比发展的认证，招股说明书披露的产品认证信息披露真实、准确。

（本页无正文，为常州中英科技股份有限公司《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市上市委审议意见的落实函》之盖章页）



（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市上市委审议意见的落实函》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



晏 璿



陈 城



声 明

本人已认真阅读常州中英科技股份有限公司本次上市委审议意见的落实函回复报告的全部内容，了解回复报告涉及问题的核查过程、本保荐机构的内核和风险控制流程，确认本保荐机构按照勤勉尽责原则履行核查程序，上市委审议意见的落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长签名：


周 杰

海通证券股份有限公司

2020年9月4日